

MSAPに最適なビアフィリング用硫酸銅めっき添加剤

# トッブルチナVT

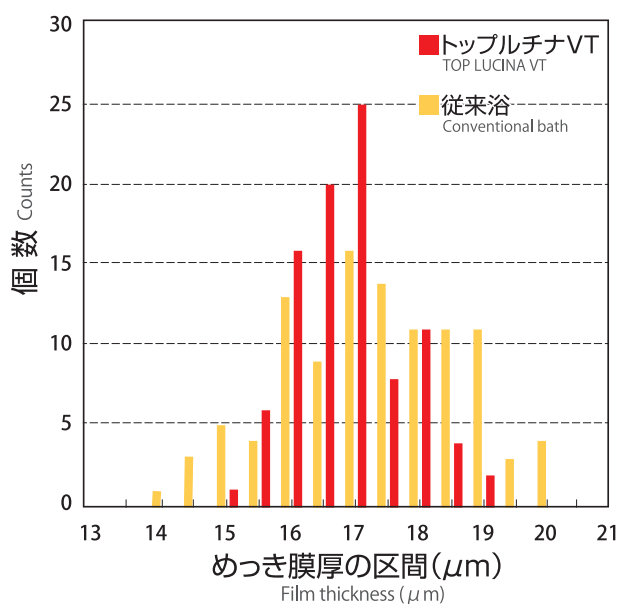
Additives for Acid Copper Plating to Via-filling (For MSAP)

## TOP LUCINA VT

- 優れたビアフィリング性能と高いスルーホールめっき性能の両立を実現
  - 浴組成をハイスロー化にすることで良好な膜厚均一性を実現
  - 全ての添加剤成分の定量分析が可能
- Realize great performance in via-filling and through-hole plating
  - Applicable to bath for high throwing power, great uniformity in film thickness
  - Quantitative analysis is possible for all additives

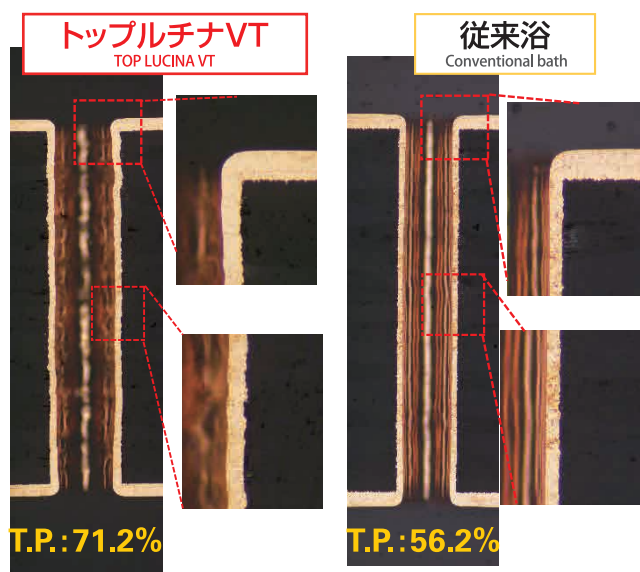
### 膜厚の均一性に優れる

Great uniformity in film thickness



### 高スローイングパワー

Great throwing power



電流密度 2.0A/dm<sup>2</sup> 穴径 0.3mm 板厚 1.6mm  
Current density 2.0A/dm<sup>2</sup> Hole diameter 0.3mm Board thickness 1.6mm

### ビアフィリング性能に優れ、浴組成のハイスロー化に対応

Great via-filling performance, applicable to bath for high throwing power

硫酸銅五水和物:200g/L

硫酸:50g/L

CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O:200g/L H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>:50g/L

硫酸銅五水和物:150g/L

硫酸:150g/L

CuSO<sub>4</sub>·5H<sub>2</sub>O:150g/L H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>:150g/L

従来浴

Conventional bath

ハイスロー化

High  
throwing-power  
bath

トッブルチナVT

TOP LUCINA VT

電流密度 2.0A/dm<sup>2</sup> 穴径 110μm ビア深さ 60μm  
Current density 2.0A/dm<sup>2</sup> Via hole diameter 110 μm Via hole depth 60 μm